

版本变更记录

版本号	日期	描述
V1.0	2012 年 08 月 18 日	EG6809 数据手册初稿
V1.1	2014 年 02 月 11 日	EG6809 SOP16 封装

目录

1. 特点	3
2. 概述	3
3. 应用领域	4
4. 引脚	4
4.1. 引脚定义 SOP16	4
4.2. 引脚描述 SOP16	4
4.3. 引脚定义 ETSSOP20	5
4.4. 引脚描述 ETSSOP20	6
5. 结构框图	7
6. 典型应用电路	8
6.1 EG6809 SOP16 典型应用电路图	8
6.2 EG6809 ETSSOP20 典型应用电路图	9
7. 电气特性	10
7.1 极限参数	10
7.2 典型参数	10
7.3 直流特性	10
7.4 交流特性	11
7.5 模拟特性	11
8. 应用信息	11
8.1 工作模式	11
8.2 数字音量控制	12
8.3 模拟输入	13
8.4 抗削顶失真功能 (ACF)	14
8.5 保护功能	15
8.6 Pop 噪声降低	15
9. 封装尺寸	16
9.1 ETSSOP20 封装尺寸	16
9.2 SOP16 封装尺寸	17

EG6809 芯片数据手册 V1.1

1. 特点

- 防削顶失真功能 (Anti-Clipping Function, ACF)
- 32 阶数字调节音量 (DVC)
- 宽的工作电源 2.2V-6V
- 超优异的全带宽 EMI 抑制性能
- 免 LC 滤波器数字调制, 直接驱动扬声器
- 高输出功率: $3.5W@V_{DDP}=V_{DDA}=5.0V, R_L=4\Omega, THD+N=10%$ $2.1W@V_{DDP}=V_{DDA}=5.0V, R_L=8\Omega, THD+N=10%$
- 高效率: $88%@V_{DDP}=V_{DDA}=5.0V, R_L=4\Omega, P_o=1W$
- 低 THD+N: $0.1%@V_{DDP}=V_{DDA}=5.0V, R_L=4\Omega, P_o=1W$
- 通道隔离度: $80dB@f_{1k}=1KHz, A_v=18dB$
- 高信噪比 SNR: $90dB@V_{DDP}=V_{DDA}=5.0V, A_v=18dB$
- 优异的“噼噗-咔嗒”(Pop-Click) 噪声抑制性能
- 静音功能
- 两声道独立关断
- 过流保护功能
- 过热保护功能
- 欠压保护功能
- 无铅 SOP16、ETSSOP20、TSSOP20 封装

2. 概述

EG6809 是一款内部集成 32 阶数字音量控制以及抗削顶失真功能且具有超低 EMI 的立体声免输出滤波器 D 类音频功率放大器。在电源电压 5V、THD+N=10%、 4Ω 负载的条件下, 输出高达 3W 的功率, 在性能与 AB 类放大器相媲美的同时, 效率高达 90%。

EG6809 的最大特点是抗削顶失真 (ACF) 输出控制功能, 可以检测并抑制由于输入音乐, 语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真 (破音), 也能自适应地防止在电池应用中由于电源电压下降所造成的输出削顶, 显著提高音质, 创造非常舒适的音乐享受, 并保护扬声器免受过载损坏。通过在 ACRC 端外接不同电阻电容值, 可灵活设置放大器的音质和输出功率。同时芯片提供了 ACF OFF 模式。

EG6809 采用独有的电磁辐射 (EMI) 抑制技术, 具有超优异的全带宽低辐射性能。辐射水平在不加任何辅助设计时仍远远低于 FCC Part15 Class B 标准值。这降低了系统电磁兼容设计难度。

EG6809 内部集成免滤波器数字调制技术, 能够直接驱动扬声器, 并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。极少的外部元件节省了系统空间和成本, 是便携式应用的理想选择。

此外, EG6809 内置的关断功能是待机电流最小化。还集成了静音功能、左右声道独立关断、扬声器输出端过流保护、片内过温保护和欠压保护等功能。芯片采用无铅 SOP16、ETSSOP20、TSSOP20 形式。

3. 应用领域

- 便携式音箱，USB 音箱，FM 插卡式音箱
- 便携式游戏机
- MP3/MP4
- 手机，笔记本电脑
- 数码相框
- 小尺寸电视/监视器

4. 引脚

4.1. 引脚定义 SOP16

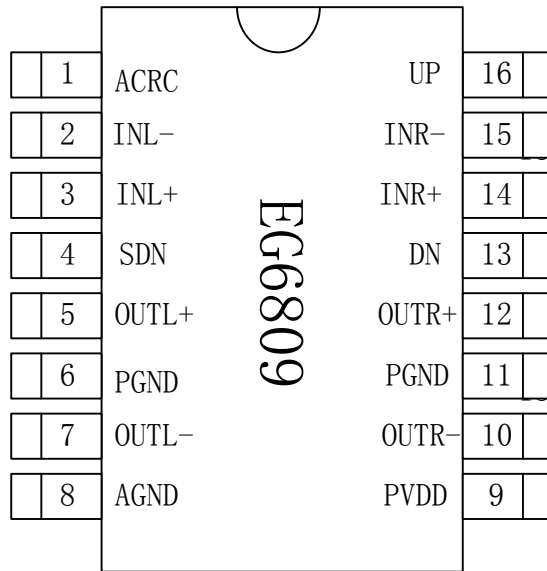


图 4-1. EG6809 管脚定义

4.2. 引脚描述 SOP16

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	ACRC	I/O	ACF 模式控制
2	INL-	A	左声道反相输入
3	INL+	A	左声道同相输入
4	SDN	I	关断控制（低电平有效）
5	OUTL+	O	左声道同相输出
6	PGND	PGND	功率地（左声道）
7	OUTL-	O	左声道反相输出
8	AGND	AGND	模拟地
9	PVDD	POWER	功率电源
10	OUTR-	O	右声道反相输出
11	PGND	PGND	功率地（右声道）

12	OUTR+	O	右声道同相输出
13	DN	I	音量减小控制（低电平有效）
14	INR+	A	右声道同相输入
15	INR-	A	右声道反相输入
16	UP	I	音量增大控制（低电平有效）

4.3. 引脚定义 ETSSOP20

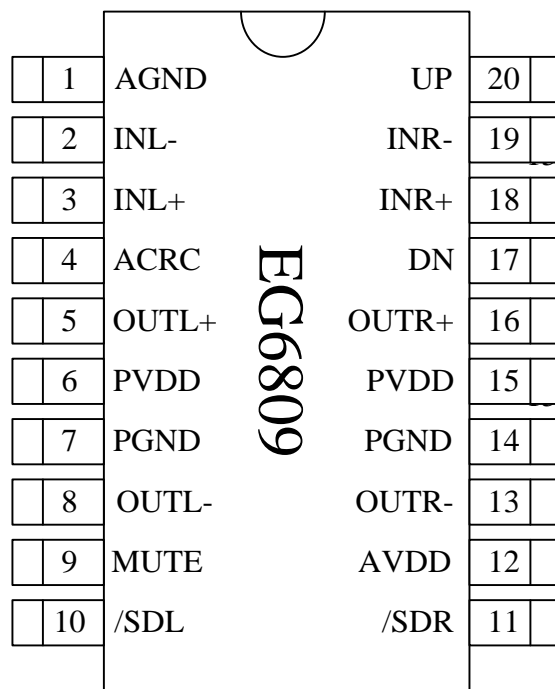


图 4-2. EG6809 管脚定义

4.4. 引脚描述 ETSSOP20

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	AGND	GND	模拟地
2	INL-	A	左声道反相输入
3	INL+	A	左声道同相输入
4	ACRC	I/O	ACF 模式控制
5	OUTL+	O	左声道同相输出
6	PVDD	POWER	功率电源（左声道）
7	PGND	GND	功率地（左声道）
8	OUTL-	O	左声道反相输出
9	MUTE	I	系统静音控制（高电平有效）
10	/SDL	I	左声道关断控制（低电平有效）
11	/SDR	I	右声道关断控制（低电平有效）
12	AVDD	PWOER	模拟电源
13	OUTR-	O	右声道反相输出
14	PGND	GND	功率地（右声道）
15	PVDD	POWER	功率电源（右声道）
16	OUTR+	O	右声道同相输出
17	DN	I	音量减小控制（低电平有效）
18	INR+	A	右声道同相输入
19	INR-	A	右声道反相输入
20	UP	I	音量增大控制（低电平有效）

5. 结构框图

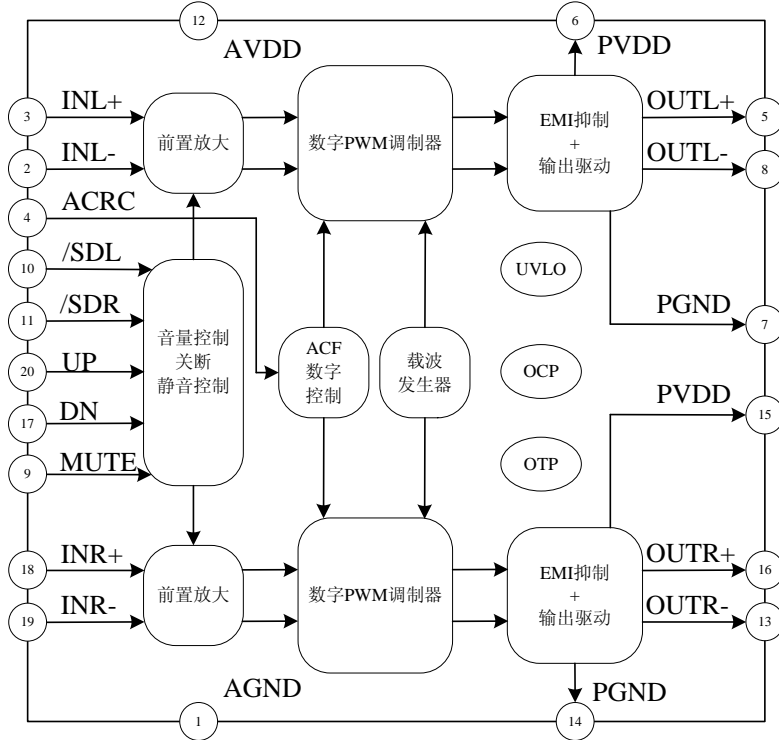


图 5-1. EG6809 ETSSOP20 结构框图

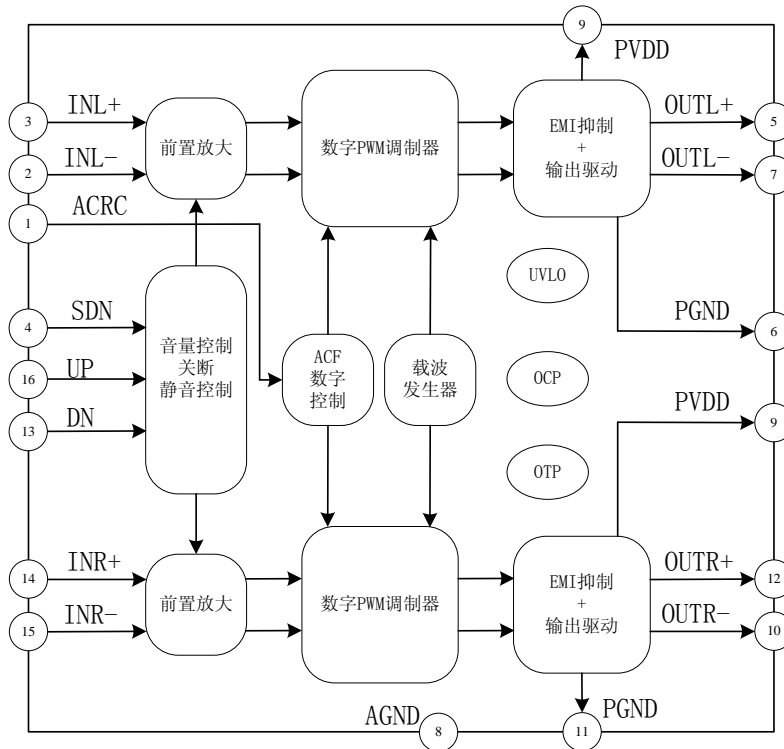


图 5-2. EG6809 SOP16 结构框图

6. 典型应用电路

6.1 EG6809 SOP16 典型应用电路图

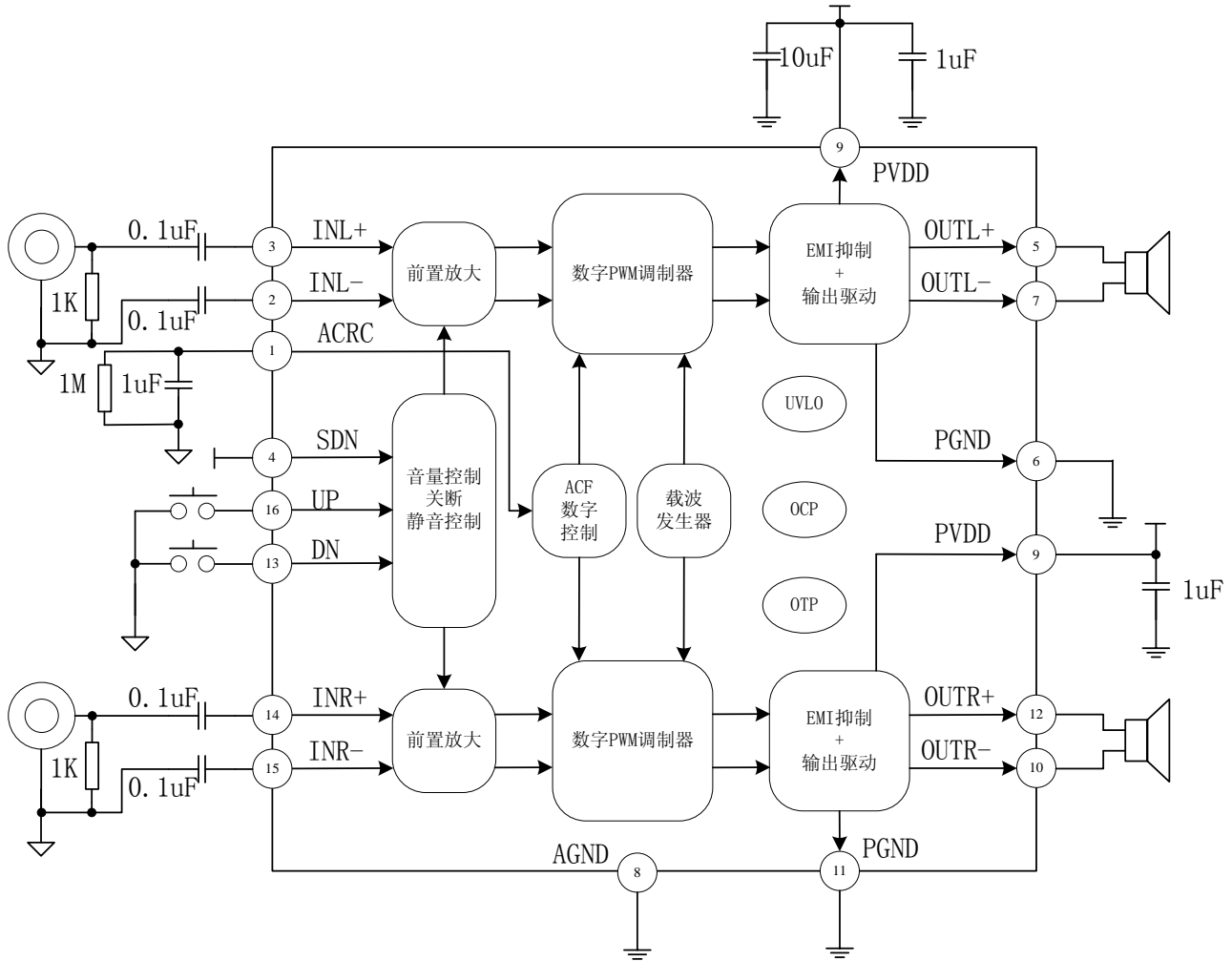


图 6-1. EG6809 典型应用电路图

6.2 EG6809 ETSSOP20 典型应用电路图

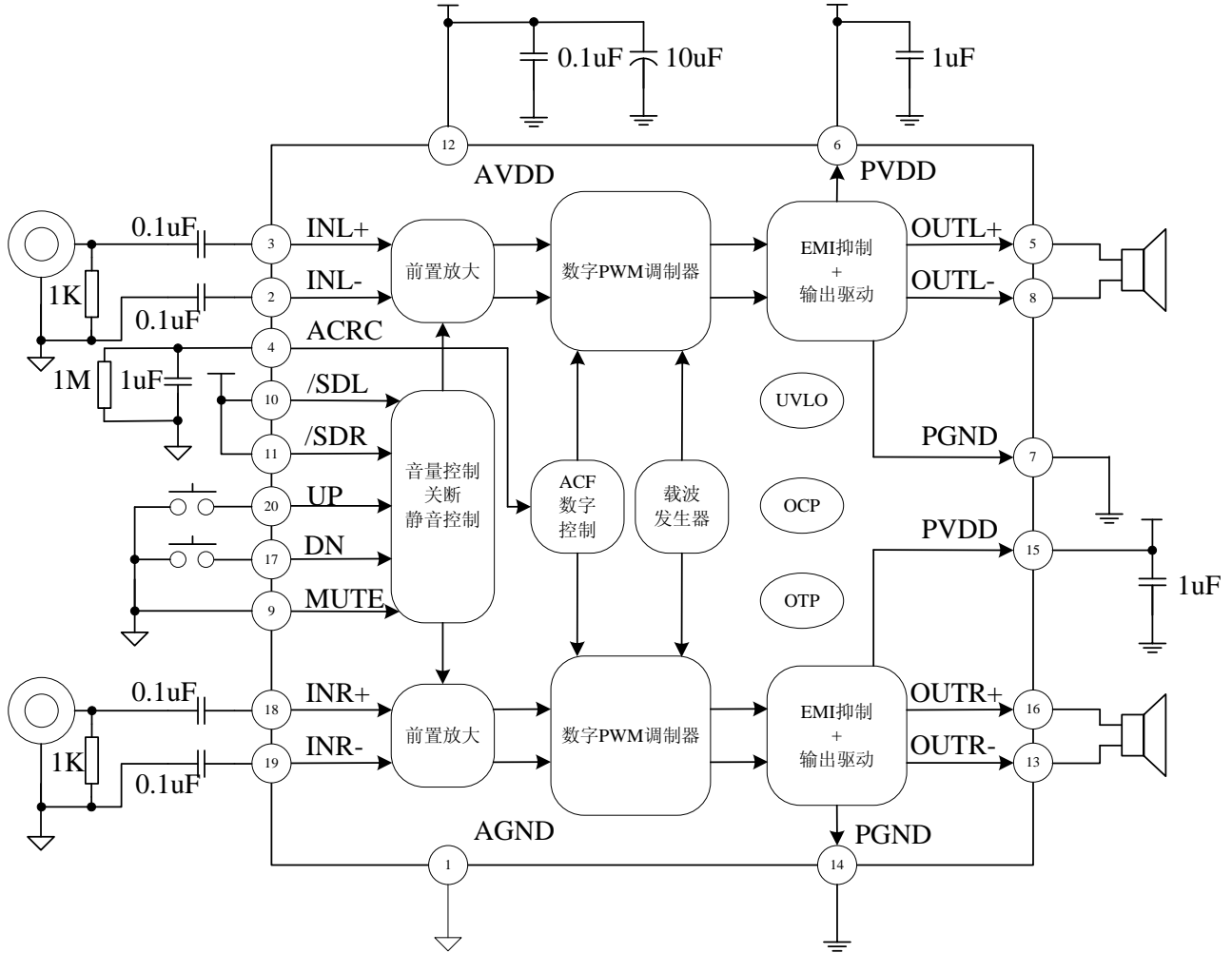


图 6-2. EG6809 典型应用电路图

7 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
V_{DDP}	功率电源电压范围	-	-0.3	7.0	V
V_{DDA}	模拟电源电压范围	-	-0.3	7.0	V
V_{IN}	输入信号电压范围	-	$V_{SS}-0.3$	$V_{SS}+0.3$	V
T_J	工作结温	-	-40	125	$^{\circ}\text{C}$
T_{STG}	存储温度	-	-50	125	$^{\circ}\text{C}$

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDP}	功率电源电压	-	2.2	5.0	6	V
V_{DDA}	模拟电源电压	-	2.2	5.0	6	$^{\circ}\text{C}$
T_a	工作环境温度	-	-40	25	85	$^{\circ}\text{C}$

7.3 直流特性

$V_{SS}=0\text{V}$, $V_{DDA}=V_{DDP}=2.7\text{V}\sim 5.5\text{V}$, $T_a=-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$, 除非特殊说明

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{UVLH}	AVDD 电源上电启动阈值	-	-	2.2	-	V
V_{UVLL}	AVDD 电源掉电关断阈值	-	-	2.0	-	V
V_{IH}	/SDL,/SDR,MUTE,UP,DN 端高电平输入电压	-	1.35	-	-	V
V_{IL}	/SDL,/SDR,MUTE,UP,DN 端低电平输入电压	-	-	-	0.35	V
I_{VDD}	P_{VDD} 静态电流	$V_{DDA}=5\text{V}$, 无负载, 无输入信号	-	6.5	-	mA
I_{MUTE}	静音电流	$V_{MUTE}=V_{ADD}=V_{DDP}=5\text{V}$	-	4.0	-	mA
I_{PD}	关断电流 (AVDD+PVDD)	/SDL=/SDR= V_{SS} , $T_a=25^{\circ}\text{C}$	-	1.0	-	μA

7.4 交流特性

$V_{SS}=0V$, $V_{DDA}=V_{DDP}=2.7V\sim 5.5V$, $T_a=-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$, 除非特殊说明

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
t_{STUP}	上电启动时间	-	-	32	-	ms
T_{AT}	启动时间	$V_{DDA}=5V, C_{ex}=1\mu f, R_{ex}=1M\Omega$	-	25	-	ms
T_{RL}	释放时间	$V_{DDA}=5V, C_{ex}=1\mu f, R_{ex}=1M\Omega$	-	0.25	-	ms
F_{PWM}	调制频率	-	-	250	-	KHz

7.5 模拟特性

$V_{SS}=0V$, $V_{DDA}=V_{DDP}=2.7V\sim 5.5V$, $T_a=-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$, 除非特殊说明

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
P_O	最大输入功率	$R_L=4\Omega$	-	3.5	-	W
		$R_L=8\Omega$				
		$F=1KHz$, $THD+N=10\%$				
AV_{Rang}	音量控制范围	$V_{DDA}=5V, C_{ex}=1\mu f, R_{ex}=1M\Omega$	-34	17.5	23.4	dB
$THD+N$	总谐波失真 (带宽: 20KHz)	$R_L=4\Omega$ $P_0=1W$	-	0.1	-	%
		$R_L=8\Omega$ $P_0=0.5W$				
		$F=1KHz$				
SNR	信噪比 (带宽: 20KHz)	$Av=18dB$	-	90	-	dB
CS	通道隔离度	$f=1KHz, Av=18dB$	-	80	-	dB
$PSRR$	电源抑制比	$f=1KHz, 200mV_{p-p}$	-	-50	-	
η	最大效率	$R_L=4\Omega, P_0=1W$	-	85	-	%
		$R_L=8\Omega, P_0=0.5W$	-	85	-	%
V_{OS}	输入失调电压	-	-	± 5	-	mV
f_{RES}	频响特性	$C_{IN}=0.1\mu f, Av=18dB, f=100Hz$ to 20KHz	-4	-	0.4	dB
Aa_{max}	ACF 最大衰减增益	-	-	-10	-	dB

8 应用信息

8.1 工作模式

EG6809 提供以下几种工作模式：典型工作模式、ACF 模式、低功耗待机模式、静音模式。

表 8-1 工作模式表

/SDR&/SDL	MUTE	ACRC	工作模式
H	L or Floating	L or H	典型工作模式
H	L or Floating	外接 Rex、Cex	ACF 模式
L	-	-	低功耗待机模式
L	H	-	静音模式

注：1: ACRC 管脚不能悬空

2: L 和 H 分别指逻辑高电平和逻辑低电平。

● 典型工作模式

在典型工作模式下，芯片按照设定增益进行信号放大。

● ACF 模式

芯片可提供 ACF 工作模式，该模式下系统能够自适应输入信号幅度或电源电压降低，以实现无削顶失真输出功能，显著提高音质，创造非常舒适的音乐享受，并保护扬声器免受过载损坏。

● 低功耗待机模式

在/SDR 和/SDL 端施加逻辑低电平，芯片右声道和左声道分别进入低功耗待机模式。该模式关闭芯片所有功能并将待机功耗降低到最小。在启动低功耗模式后，输出端为弱下拉状态（通过高阻接地）。当该模式解除后，经过一段启动时间（ T_{SRUP} ）进入正常工作状态。

● 静音模式

EG6809 带有静音工作模式，当 MUTE 管脚置逻辑高电平时，进入该模式。当 MUTE 管脚置逻辑低电平时，电路可立即恢复到正常工作模式。当 MUTE 引脚悬空时，静音模式将不被触发。

注：静音模式控制等级低于低功耗待机模式，但系统能快速关闭/启动，不需要经过 T_{STUP} 启动时间，不引起“噼噗-咔嚓”声。

8.2 数字音量控制

EG6809 可通过外部管脚 UP、DN 来实现 32 阶数字音量控制功能。内部计数器时钟频率（ f_{CLK} ）由下述表达式确定：

$$f_{CLK} = f_{OSC} / 2^{13}$$

其中 f_{OSC} 为内部振荡器频率，典型值为 250KHz， f_{CLK} 典型值为 33Hz（cycle=30ms）。

将 UP 或 DN 管脚置低电平可实现音量上升或下降，控制时序如图 1 所示。其中 T_1 为抗抖动时间，经过 T_1 后音量上升或下降一阶； T_2 为音量维持不变的时间，经过较长时间 T_2 后音量继续上升或下降一阶；此后每隔较短时间 T_3 ，音量即改变一阶，可实现音量的连续快速变化。

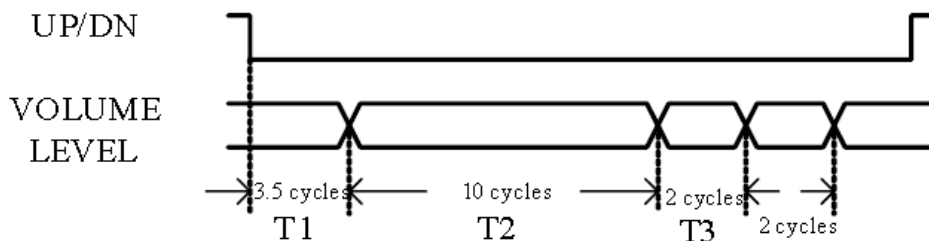


图 8-1. 音量控制时序图

操作事项:

- 1: UP 和 DN 同时置低电平时, 音量维持不变;
- 2: 从静音状态恢复/关断模式恢复时, 之前设置的音量不改变;
- 3: 初始上电时,系统增益默认值为 17.5dB;
- 4: 32 阶音量控制增益见表 8-2。

阶数	增益 (dB)	阶数	增益 (dB)	阶数	增益 (dB)
1	MUTE	12	-5.6	23	14.7
2	-34.0	13	-3.8	24	15.5
3	-30.4	14	-2.4	25	16.6
4	-27.9	15	-0.3	26	17.5
5	-26.0	16	1.2	27	18.5
6	-21.9	17	3.1	28	19.5
7	-18.4	18	5.3	29	20.6
8	-17.0	19	7.1	30	21.5
9	-14.0	20	9.0	31	22.5
10	-11.3	21	11.0	32	23.4
11	-8.8	22	12.9	-	-

注: 增益指的是系统整体增益

8.3 模拟输入

对于差分信号输入时,通过隔直电容 C_{IN} 将左声道信号输入到 INL+ 和 INL-端, 见图 8-2。对于单端信号输入时, 通过隔直电容将信号输入到 INL+端。同时, INL-端必须通过一个电容 C_{REF} (与 C_{IN} 相同的值)到地, 见图 8-3。右声道输入情况同左声道类似。

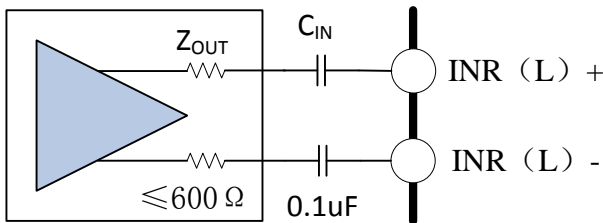


图 8-3 差分输入

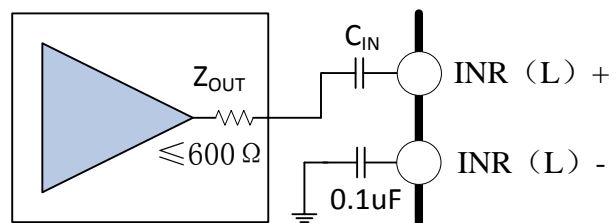


图 8-3 单端输入

另外, 若入端 (INL+和 INL-, 或者 INR+和 INR-) 没有接音源输入, 应将没有用到的通道的两个输入端短接, 并通过一个电容连接到地, 见图 8-4。该电容值与上面所述隔直电容值相同(0.1μF)。

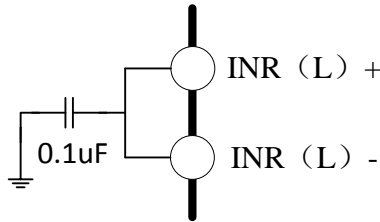


图 8-4 无用声道输入端的连接

8.4 抗削顶失真功能 (ACF)

当输入信号幅度过大或者电源电压降低时，输出会出现削顶失真,并可能产生扰人心烦的破音。抗削顶失真功能 (ACF) 能自适应输入信号幅度或电源电压降低,通过检测输出信号幅度来自动调整环路增益,达到无削顶失真目的,大大改善了音质效果,并最大化输出功率。抗削顶失真功能 (ACF) 原理如图 8-5 所示。

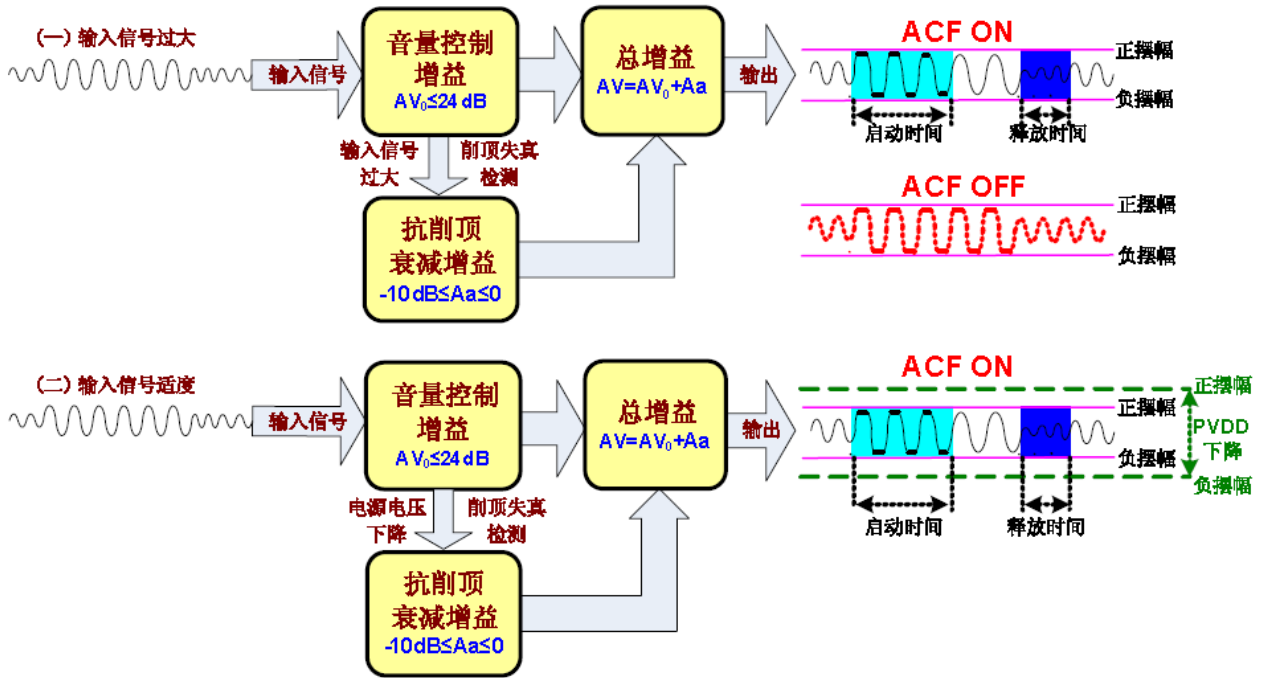


图 8-5 抗削顶失真功能 (ACF) 的原理框图

ACF 模式下启动时间和释放时间可通过在 ACRC 端外接不同的电阻(R_{ex})和电容(C_{ex})值灵活地设置,连接方式见图 8-6 所示。

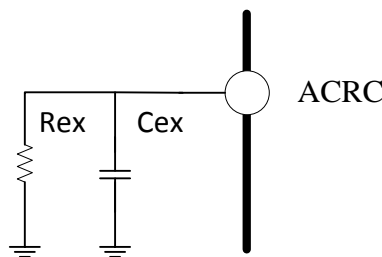


图 8-6 ACF 模式引脚 ACRC 的外接方式

另外，THD 与输出功率也可通过在 ACRC 端外接不同的电阻(R_{ex})值灵活地设置，见表 8-3。

表 8-3 THD 与输出功率对应关系 ($V_{DDA}=V_{DDP}=5.0V$)

测试条件: $V_{DDA}=V_{DDP}=5.0V$; $C_{ex}=1\mu f$; $R_L=4\Omega$		
$R_{ex}(K\Omega)$	THD+N(%)	$P_O(W)$
1000	1.0	2.3
180	3.0	2.4
75	5.0	2.7
20	10.0	3.0
10	15.0	3.5

8.5 保护功能

EG6809 具有以下几种保护功能：过流保护、过温保护、欠压保护。

- 过流保护：

当检测到输出端短路、输出端对电源或地短路时，会自动启动过流保护功能来防止芯片损坏。左右声道过流保护功能相互独立。在启动过流保护模式后，输出端为高阻态。通过在 /SDR 端施加逻辑电平能使右声道从过流模式恢复，同样情况适用于左声道。另外，重新上电能使双通道同时从过流保护模式中恢复。

- 过流保护：

当检测到芯片温度超过一定值是，该功能自动启动来防止芯片损坏。在启动过温保护模式后，输出端为弱下拉状态（通过高阻连到地）。芯片温度恢复到正常时，该模式自动解除。

- 过温保护

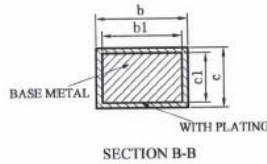
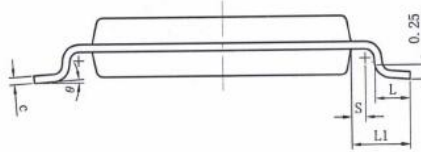
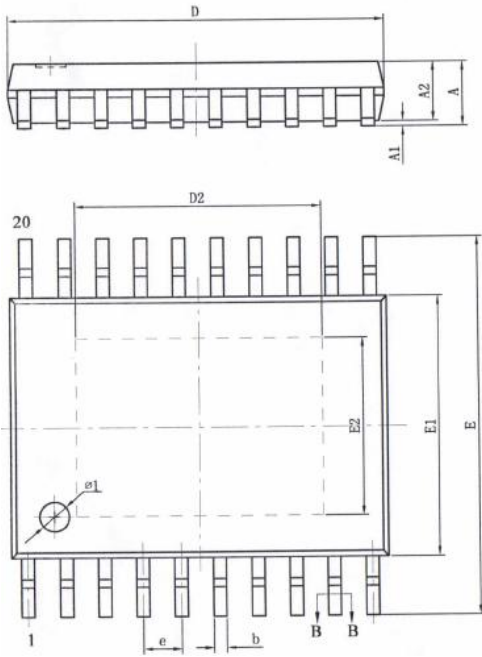
当检测到 AVDD 电压低于 V_{UVLL} 启动欠压保护功能。当检测到 AVDD 电压高于 V_{UVLL} ，该模式自动解除。在启动欠压保护模式后，输出端为弱下拉状态（通过高阻接地）。当欠压保护模式解除后，经过一段启动时间 (T_{STUP}) 进入正常工作状态。

8.6 Pop 噪声降低

芯片内部集成有 Pop 噪声抑制电路，专门抑制上电/掉电/待机/恢复等转换中出现 Pop 噪声。

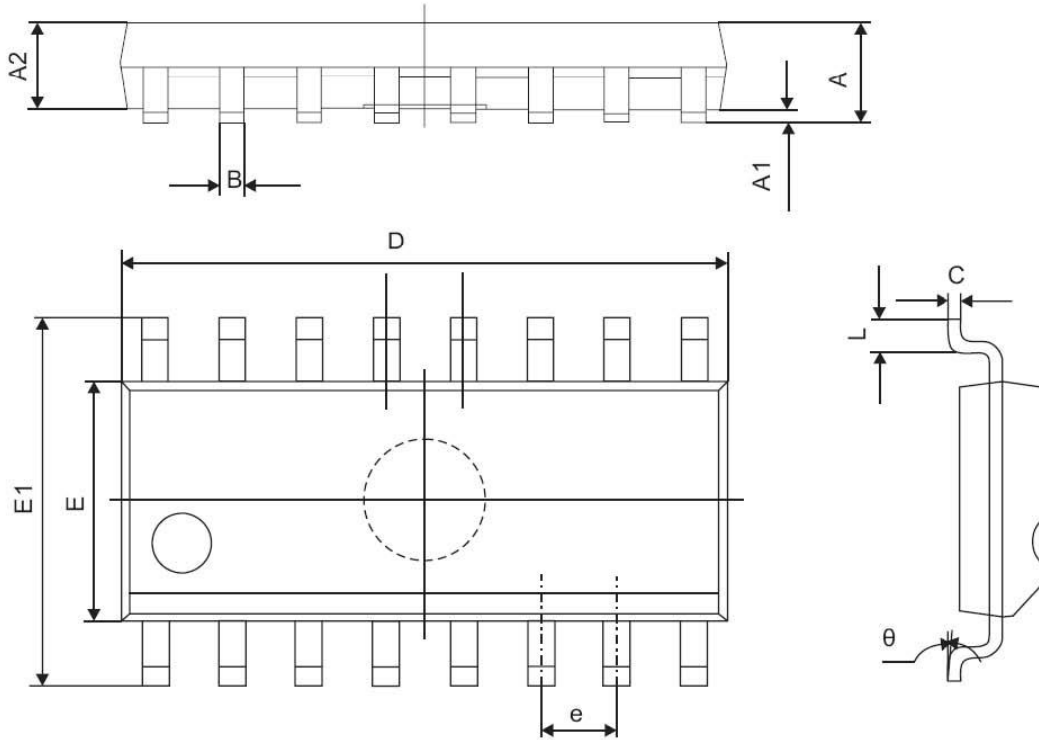
9 封装尺寸

9.1 ETSSOP20 封装尺寸



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.20
A1	0.05	—	0.15
A2	0.80	1.00	1.05
b	0.19	—	0.30
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.09	—	0.20
c1	0.09	—	0.16
D	6.40	6.50	6.60
D2	4.10	4.20	4.30
E2	2.90	3.00	3.10
E1	4.30	4.40	4.50
E	6.20	6.40	6.60
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00BSC		
S	0.20	—	—
$\phi 1$	$\phi 0.8 \times 0.05 - 0.10DP$		
θ	0	—	8°
L/P载体尺寸 (mil)	118*165 (C)		

9.2 SOP16 封装尺寸



符号	尺寸 (mm)	
	Min	Max
A	1.350	1.750
A1	0.100	0.250
A2	1.350	1.550
B	0.330	0.510
C	0.190	0.250
D	9.800	10.000
E	3.800	4.000
E1	5.800	6.300
e	1.270 (TYP)	
L	0.400	1.270
θ	0°	8°